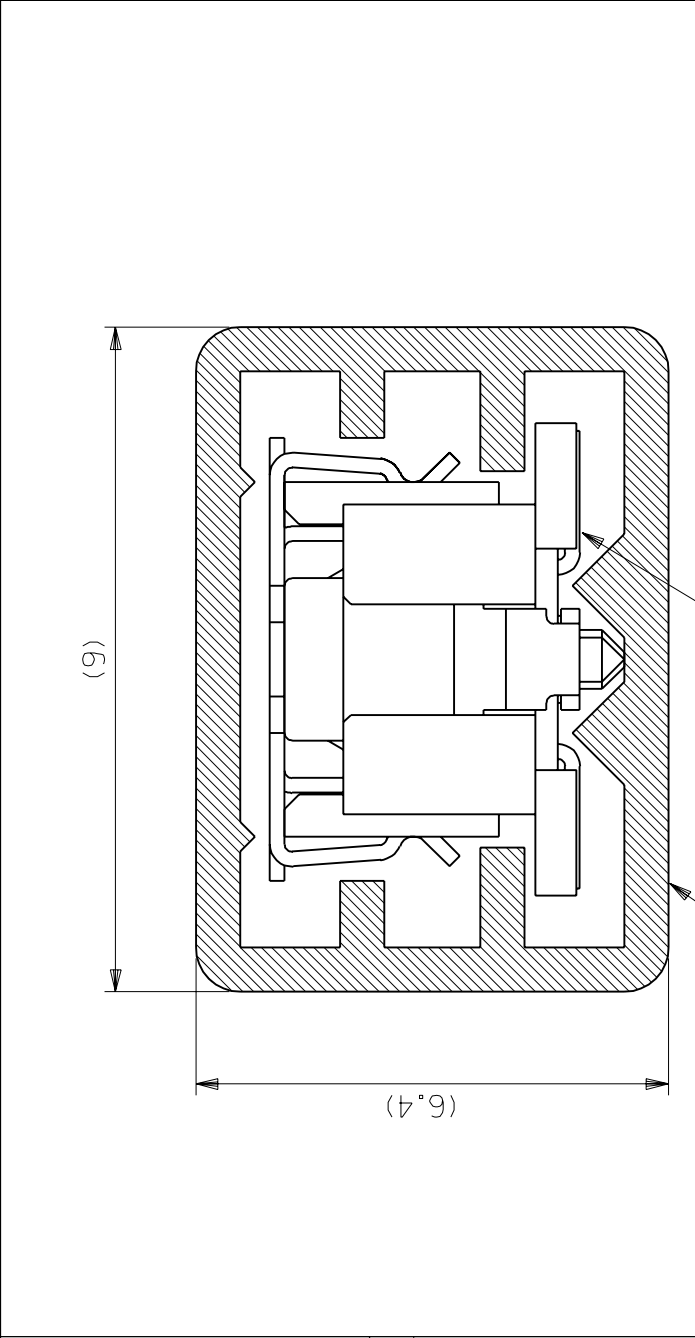


DWG. NO.
SD-52885-****5



5	52885-2405	240
6	▲ -2005	200
7	-1805	180
8	-1605	160
9	-1405	140
10	-1205	120
12	-1005	100
13	-0905	90
14	-0805	80
15	-0705	70
16	-0685	68
17	-0605	60
20	-0505	50
23	-0405	40
27	▼ -0305	30
33	52885-0205	20
梱包数量 QUANTITY	ENG. NUMBER	極数 CKT. NO.

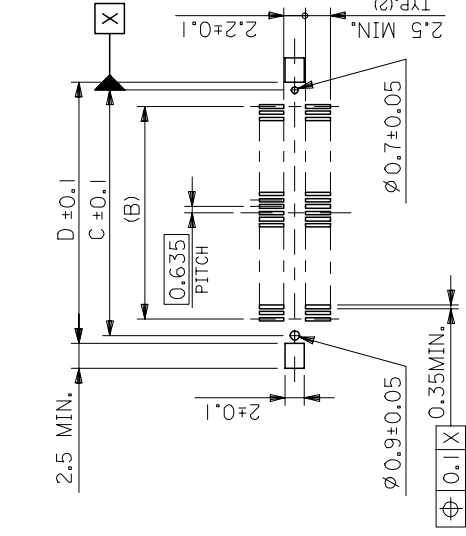
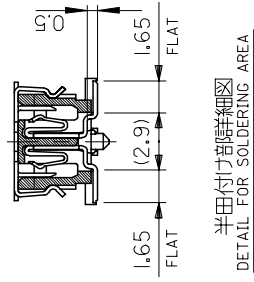
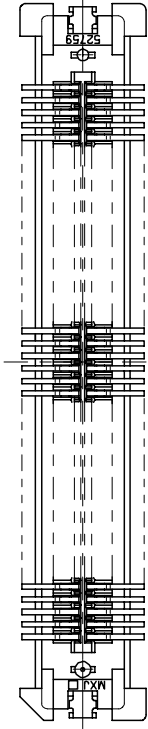
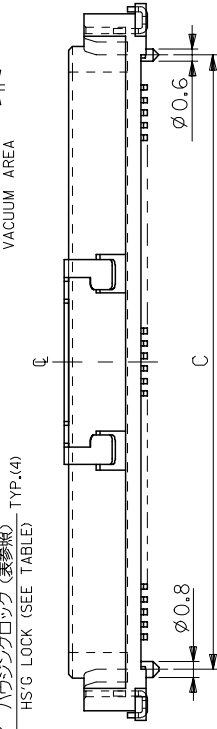
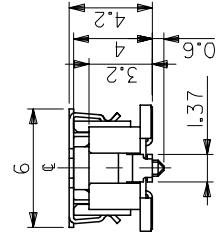
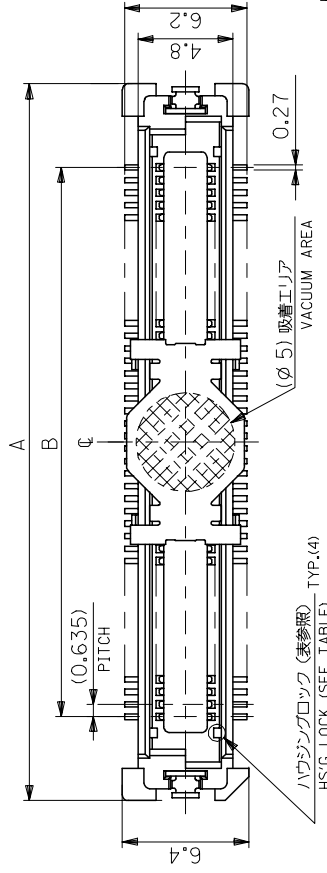
MOLEX-JAPAN CO.,LTD. moLEX日本モレックス株式会社		
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
TITLE 名称		
52885-***2		
STICK PACKAGING		
DWG. NO.	REV	0
SD-52885-***5		

材料 MATERIAL		スティック：ポリ塩化ビニル STICK：P.V.C
仕上げ FINISH		—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—
被覆外径 INS. RANGE		—#—
DRAWN BY '97/09/26		CHK'D BY
Y.S. Shimoyama		Y. Sasao
APP'D BY		尺度
DR. 日付		SCALE 10 - 1
REVISION RECORD		

- 注)
NOTES.
- 1。スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 2。全長：508^{+1.0}-2.5
TOTAL LENGTH
- 3。肉厚：0.6±0.2
THICKNESS
- 4。量産対応済の極数については
SD-52885-***2を参照下さい。
SEE SD-52885-***2
FOR AVAILABLE ITEMS.

角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	±0.3
10以上	30未満	±0.25
10未満	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
: MM



推奨基板寸法

RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE:2-1)

ES	100%ロック HSY LOCK	DIMENSION STYLE				SCALE	DESIGN UNITS	 METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
		MM ONLY							
		D	C	B	A				
無し NO	80.47	78.87	75.565	84.07	52885-2404	52885-2405	52885-2402	240	○
	67.77	66.17	62.865	71.37	—	—	—	200	—
	61.42	59.82	56.515	65.02	—	—	—	180	—
	55.07	53.47	50.165	58.67	52885-1604	—	—	160	○
	48.72	47.12	43.815	52.32	—	—	—	140	○
	42.37	40.77	37.465	45.97	—	—	—	120	○
	36.02	34.42	31.115	39.62	52885-1004	—	—	100	○
	32.85	31.25	27.94	36.45	—	—	—	90	○
	29.67	28.07	24.765	33.27	—	—	—	80	○
	26.5	24.9	21.59	30.1	—	—	—	70	○
有り YES	25.86	24.26	20.955	29.46	—	—	—	68	—
	23.32	21.72	18.415	26.92	—	—	—	60	○
	20.15	18.55	15.24	23.75	—	—	—	50	○
	16.97	15.37	12.065	20.57	—	—	—	40	○
	13.8	12.2	8.89	17.4	—	—	—	30	○
100%ロック HSY LOCK	10.62	9.02	5.715	14.22	52885-0204	52885-0205	52885-0202	20	○
					エンボス加工 EMBOSSED PACKAGING	エンボス加工 STICK PACKAGING	製品番号 ENG. NO.	納期 LQTY. NO.	備考 REMARKS

REV	DESCRIPTION
REVISED	EC NO: J2005-3512
	DRWN: MABEI
	CHKD: KTOYODA
	APPR: NUKITA
	2005/05/26
	2005/05/27
	2005/05/31

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE	
		MM ONLY	
10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY K. KASAHARA	DATE 19% / 02 / 05
10 OVER	± 0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE 19% / 02 / 05
30 OVER	± 0.3	APPROVED BY H. IKESUGU	DATE 19% / 02 / 05
ANGULAR	± 1 °	MATERIAL NO.	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE	
		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INCORPORATED AND

SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION
TITLE			
0.635 PITCH B-TO B S/T REC. HSG ASSY			
 MOLEX INCORPORATED			
DOCUMENT NO.	SHEET NO.		
SD-52885-006	1 OF 1		
ALL INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			

- 注) NOTES

1. 材質
ハブリング: ガラス入りLCP, 白色, UL 94 V-0
HOUSING: G.F. LCP, WHITE, UL 94 V-0
ターミナル: 銅合金 (t = 0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
変圧力バー: ステンレス (t = 0.2)
VACUUM COVER: STAINLESS STEEL (t = 0.2)
補強金具: 銅合金 (t = 0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY (t = 0.25)
2. メッキ仕様
PLATING
ターミナル: 接点部: 金メッキ 0.25 マイクロメートル以上
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
TERMINAL
半田付部: 半田メッキ 1.0 マイクロメートル以上
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM
補強金具: 半田メッキ 3.5 マイクロメートル以上
FITTING NAIL: TIN-LEAD 3.5 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: 銅メッキ 1.0 マイクロメートル以上
UNDER-PLATING: COPPER 1.0 MICROMETER MINIMUM
3. テールのバッキング寸法
TAIL COPLANARITY
テール平坦度は, 0.1 MAX. とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
4. エンボス対応部材の選定については, SD-52885-***4 を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-52885-***4.